

| 期刊 | 编辑观点 | 高层观点 | 封面故事 | 趋势洞察 | 元件与模组 | 分销与供应链 | 制造与工艺 | 特刊 |
|---|------|------|-------------------|--------------|----------|-------------|-------|----------|
| 1 月刊 广告预订截止日期: 2025 年 11 月 21 日 材料提交截止日期: 2025 年 11 月 28 日 | • | • | 2026年电子行业趋势 | 消费电子市场现状 | 电源芯片/模块 | 电子/分销行业新年展望 | - | - |
| 2 月刊 广告预订截止日期: 2025 年 12 月 22 日 材料提交截止日期: 2025 年 12 月 30 日 | • | • | 全球供应链的多元链潮 | 芯片出海 | 存储主控 | 可持续供应链 | 自动化测试 | - |
| 3 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 1 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 1 月 28 日 | • | • | 智能制造与数字化供应链 | 机器视觉 | 传感器 | 供应链管理 | - | - |
| 4 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 2 月 25 日 材料提交截止日期: 2026 年 2 月 27 日 | • | • | AI手机/AI PC应用 | VR/AR | 电容/电阻/电感 | 元器件电商 | PCB制造 | - |
| 5 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 3 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 3 月 30 日 | • | • | 新能源与智能驾驶深度融合 | AI定义汽车 | 无线模块 | 供应链服务 | - | - |
| 6 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 4 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 4 月 30 日 | • | • | 2025年度全球/中国分销商排名 | 2025国产存储市场分析 | 光通信芯片 | 国产供应链 | 半导体设备 | - |
| 7 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 5 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 5 月 29 日 | • | • | 国产SiC急速上车 | 脑机接口/智慧医疗 | GaN器件 | 智能仓储 | - | - |
| 8 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 6 月 19 日 材料提交截止日期: 2026 年 6 月 30 日 | • | • | 人形机器人量产元年 | 工业电子市场 | 微型电机 | 技术分销 | 半导体封装 | - |
| 9 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 7 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 7 月 30 日 | • | • | 智能家居迈向主动智能 | 智能穿戴 | RISC-V | 小批量分销 | - | - |
| 10 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 8 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 8 月 28 日 | • | • | AI眼镜催生下一个供应链风口 | 显示趋势 | ASIC芯片 | 分销商并购 | 新材料应用 | - |
| 11 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 9 月 21 日 材料提交截止日期: 2026 年 9 月 25 日 | • | • | GPU/AI芯片:万卡智算集群构建 | 数据中心 | 图像传感器 | AI赋能分销 | - | - |
| 12 月刊 广告预订截止日期: 2026 年 10 月 20 日 材料提交截止日期: 2026 年 10 月 30 日 | • | • | 封芯跃迁:先进封装重塑半导体疆界 | 晶圆代工趋势 | 射频前端 | 库存管理 | 晶圆制造 | 分销与供应链专刊 |

有关编辑查询和其他相关事项：
请与 Clover Lee (clover.lee@aspencore.com) 联系。

注：封面故事、元件与模组、分销与供应链所列主题需采访企业；编辑观点、趋势洞察、制造与工艺所列主题以深度原创为主；发行人保留对以上文章删除及改动的权利。